

加速拼接半导体“版图”

小米正在通过投资加速拼接其在半导体领域的技术“版图”，以掌握更多半导体核心技术。

小米公司布局芯片产业的开端还要从2018年1月23日说起，正是在这一天小米开启了攀登半导体产业高峰的第一步。当日，小米通过顺为资本对南芯半导体进行了A轮投资，而正是这笔金额为数千万人民币的投资打响了小米对半导体产业投资之战的第一枪。

随后，小米持续在芯片投资领域加码，相继入股了云英谷科技、乐鑫科技、芯原微电子等数家半导体公司，覆盖包括Wi-Fi芯片、射频（RF）芯片、MCU传感器和FP-GA在内的多个芯片产品。总体来说，小米在芯片领域的投资涉及电子产品核心器件、新材料、新工艺、手机及智能硬件供应链，同时又涵盖智能制造、工业自动化等相关领域，涉足领域相当广泛。

今年下半年，小米长江产业基金投资杭州芯迈半导体，持股比例为2.7027%。据悉，杭州芯迈半导体公司经营范围包括系统集成、集成电路及模块、电子产品的技术开发、技术服务、成果转让、集成电路芯片的生产（限分支机构经营）、测试、安装、电子产品、集成电路芯片销售等多个领域。

从小米对投资半导体企业的“浓厚兴趣”中可以看出，小米正在通过投资这一方式，加速拼接其在半导体领域的技术“版图”，以便能够掌握更多且更全面的半导体核心技术。

“造芯”之路并不顺畅

小米一直在自研芯片方面有着强烈的野心，但小米的“造芯”之路走得并不顺畅。

在各大手机厂商纷纷开始自研芯片的潮流之下，小米究竟为何会对半导体产业情有独钟，在投资半导体企业方面持续大做文章？有声音认为，小米加速对半导体领域布局、频频投资半导体企业，是其自研芯片失利后，在半导体领域的自救之法。有关人士认为，未来小米可能会放弃自研芯片，转向投资半导体企业，以掌握更多更全面的半导体技术。

2020年投资半导体企业多达19家  
小米“造芯”开启加速度

本报记者 沈丛

早在2017年小米“我心澎湃”发布会上，小米创始人兼CEO雷军就曾说过：“芯片是手机科技的制高点。”这足以显示小米对芯片产业的高度重视。为了能够站在这个科技制高点上，近几年来，小米在攻克半导体技术方面可谓是煞费苦心，动作频频。在成立长江产业基金后，小米又连续投资半导体企业，加速芯片产业布局的野心显而易见。据悉，为了加速布局AIoT领域芯片版图，小米近期又投资了两家半导体企业，使得小米长江基金在2020年公开投资的半导体企业数量多达19家。从小米近期的频频动作中可以看出，小米迫切希望能通过投资半导体产业这一方式，实现其站在科技制高点的梦想。

这类声音听起来似乎有一定道理。小米一直在自研芯片方面有着强烈的野心，但小米的“造芯”之路走得并不顺畅。2017年，小米正式发布了澎湃S1处理器，但是这款精心打造的处理器在性能、工艺和功耗等方面与竞争对手的产品差距过大，因此澎湃S1处理器在不久之后便随着搭载它的小米5C一起，悄然退出了市场。此外，备受瞩目的澎湃S2芯片也多次受挫，面临很多困境。从2018年开始，业内屡次传出“澎湃S2芯片多次流片失败”等

类似传言，还有消息称小米已经准备放弃S2芯片了。据悉，截至2019年年底，澎湃S2流片一共失败了六次，每次流片失败后进行再次研发的费用高达几十万元。

种种迹象表明，对小米来说，此时此刻，另辟蹊径或许是其脱离眼前困境的最佳解决之道。相比于苦苦研发需要深厚积累的半导体技术，小米“转头”投资半导体企业、“曲线”布局半导体领域这一发展之道似乎更为合理。但与大多数人的猜测与推理不同，创道投资咨询总经理步日欣

告诉记者，事实上，小米通过投资方式大规模布局上游电子元器件这类动作，与其自研芯片之路走得不顺利这一事件并无必然的因果关系。小米当年自研芯片的核心在于手机处理器芯片，并没有对芯片产业进行全产业链布局。而现在小米实施的投资战略主要是从产业链上下游协同以及供应链安全等方面考量的。为了使其投资战略得到落实，通过投资半导体企业来扩大“朋友圈”无疑是保障未来供应链安全的最有效措施之一。

围绕核心产品供应链布局芯片

投资但不收购半导体企业，会给这些企业更多自主权，而小米选择的正是这一策略。

在半导体投资这条路上，小米并没有“独揽天下”之意。赛迪顾问集成电路产业分析师张翔向记者介绍道，小米在半导体领域的投资主要是围绕自身核心产品供应链，重点布局物联网、智能家居、移动互联设备、可穿戴设备等领域。比如小米投资的晶晨股份和乐鑫科技这两家企业，涉及的业务领域就与小米自身核心产品供应链息息相关。据了解，晶晨股份主要业务涉及智能机顶盒SoC芯片、智能电视SoC芯片、AI音视频系统终端SoC芯片产品，而乐鑫科技的主攻方向则是Wi-Fi及蓝牙芯片产品。这些企业研发生产的产品可以和小米自身供应链形成协同发展，并配置到小米自己生产的产品中。小米投资上游半导体企业，在带来资金盈利的同时，也给上游半导体企业提供了稳定的出货渠道，实现了生态链的双赢。对上游核心供应链企业和技术企业的投资则表明了小米增强供应链话语权，以构建深厚技术基础的决心。由此可见，通过投资的方式与上游半导体企业走向投资双赢的“造芯”之路，正是小米所希望的。

“与华为100%控股哈勃投资不同，在小米长江基金中，小米出资仅占17.3%。这也意味着，与华为的‘战略扶持’式投资相比，小米的投后风格更偏向市场化，更有益于和被投资企业的对接，也更能深入地了解下游终端用户的需求。”步日欣说道。

集邦咨询分析师姚嘉洋也认为，因为中国大陆本身就具有庞大的市场内需，所以在终端系统领域发展的相关企业，如小米、华为与阿里巴巴等，都展现出了相当惊人的发展速度。在半导体产业本土化策略方面，投资国内半导体企业是极为正常且合理的策略。投资但不收购半导体企业，会给这些半导体企业更多的自主权，而小米选择的正是这一策略。由此可见，小米在成为这些半导体公司“金主”的同时，也在成为它们不容忽视的重要客户。

面临“造芯难”的手机厂商不是只有小米。对任何手机厂商而言，“造芯”都是一场“生死未卜”的远征，行路难，且多歧路。小米是否能够通过投资半导体企业的方式来发力芯片产业，投资半导体企业这一方式又能否帮助小米实现站在科技制高点的梦想？这所有的一切还需要时间来检验。

中国电子报

一报在手 行业在握

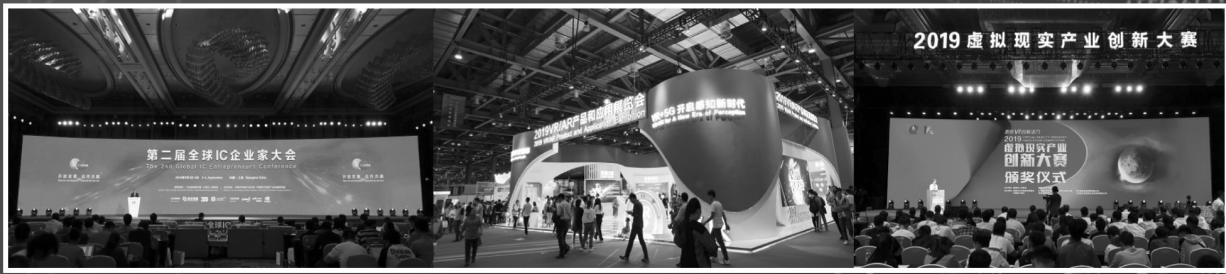
融媒体服务



- 报纸出版
- 官方网站（电子信息产业网www.cena.com.cn）
- 官方微信（公众号cena1984）
- 官方微博(http://weibo.com/cena1984)
- 视频平台（抖音、快手、央视网、人民视频等）

- 视频服务（视频制作、在线直播、在线会议等）
- 平台推广(学习强国、今日头条、百度百家等)
- 内参专报
- 行业报告
- 图书出版

会赛展服务



- 会议活动
- 专业大赛
- 展览展示
- 专业培训
- 政府服务

- 企业定制
- 产品评测
- 舆情监测
- 数据营销
- 招商引资

中国电子报社是工业和信息化部主管的传媒机构，创建于1984年。

目前，中国电子报社拥有集报刊、图书、网站、微信、微博、音视频等融媒体传播，会议活动、展览展示、专业大赛、定制服务等会赛展训服务于一体的立体化、多介质产品，成为凝聚行业力量、服务行业发展的重要平台。

《中国电子报》（国内统一连续出版物号：CN 11-0005 邮发代号：1-29）是具有机关报职能的行业报，主要报道内容包括：产业要闻、政策解读、集成电路、新型显示、智能终端、家用电器、5G、人工智能、物联网、工业互联网、移动互联网、大数据、云计算、区块链、VR/AR等。



官方微信



官方网站

在这里  
让我们一起把握行业脉动  
www.cena.com.cn

地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦18层  
电话：010-88558808/8838/9779/8853  
传真：010-88558805